

# 广州回收CRHJ华润华晶IC芯片

产品名称	广州回收CRHJ华润华晶IC芯片
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

另外按照JEDEC（美国联合电子设备委员会）标准把引脚中心距为0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm的QFP称为MQFP（metric quad flat package）。日本电子机械工业会标准所规定引脚中心距.55mm、0.4mm、0.3mm等小于0.65mm的QFP称为QFP（FP）（QFP fine pitch），小中心距QFP。又称FQFP（fine pitch quad flat package）。但现在日本电子机械工业会对QFP的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别，而是根据封装本体厚度分为QFP（2.0mm~3.6mm厚）、LQFP（1.4mm厚）和TQFP（1.0mm厚）三种。

QFP的缺点是，当引脚中心距小于0.65mm时，引脚容易弯曲。为了防止引脚变形，现已出现了几种改进的QFP品种。如封装的四个角带有树脂缓冲垫的BQFP（见11.1）；带树脂保护环覆盖引脚前端的GQFP；在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专用夹具里就可进行测试的TPQFP。在逻辑LSI方面，不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP里。引脚中心距小为0.4mm、引脚数多为348的产品也已问世。此外，也有用玻璃密封的陶瓷QFP（见11.9）。

LM324PT

LMV358LIDT

LM358ADT

MAX2659ELT+T

LM158DT

LM311DT

LMV324LIDT

LM319DT

LM2904WYDT

LM219DT

LM833DT

LM258QT

LM2903YPT

LM2903WYDT

LF351DT

TS27L2CDT

LM358PT

LM358ST

TL074IDT

STD7NM80

LD1086DTTR

STP7NK40Z

STB14NK60ZT4

STFW4N150

L7815CD2T-TR

STD3NK50ZT4

STP6N95K5

STN3NF06L

STD5N20LT4

VND7NV04TR-E

VNP35N07-E

STD3N62K3

STW38N65M5

STB23N80K5

STB4NK60ZT4

STF13N60M2

VNB10N07-E

VND5N07TR-E